

## 2018 Moldex3D 全球模流达人赛 作品授权及刊登同意书

请于 **2018 年 9 月 26 日(三)**前，亲签后扫描 E-Mail 至 [talentawards@moldex3d.com](mailto:talentawards@moldex3d.com)

本人(及本人团队)\_\_\_\_\_ (以下简称本人)因参加科盛科技股份有限公司(以下简称科盛科技)主办之「2018 Moldex3D 全球模流达人赛」(以下简称本活动)，同意以下本活动参赛办法及规定，并授予科盛科技以下权利:

1. 本人拥有完全权利与权限签署并履行本同意书，且已取得签署本同意书必要之第三者同意与授权。
2. 本人兹同意将所有缴交本活动的参赛作品(含文字、CAD模型、图片及影片)等内容，永久无偿授权科盛科技及其国内外关系企业及其授权之第三方，不限载体、用途、使用次数、地区、期间，包含但不限于散布、重制、发行、改作、翻译、再授权、公开传输、公开展示、公开播送与公开发表之权，提供大众进行检索、浏览、下载、传输、打印及公开使用等。
3. 本同意书为专属授权。本人保证并无侵害任何第三人之著作权、专利权、商标权、商业机密或其他知识产权，且未曾参加其他竞赛得奖。作品如涉及著作权之侵权或其他不法行为，概由本人自行负责，科盛科技得取消得奖资格并追回奖金、奖状及奖品。
4. 本人作品若有侵害他人权利或涉及违法，本人愿负全部之赔偿责任。若因此致科盛科技受有损害，本人愿负赔偿责任。
5. 本人已详阅并同意遵守[本次参赛之各项相关规定](#)。

**此致**

**主办单位：科盛科技股份有限公司**

**立同意书人(团队代表)**

\_\_\_\_\_  
(签名并盖章)

\_\_\_\_\_  
身分证字号                      年      月      日

**主管/指导教授**

\_\_\_\_\_  
(签名并盖章)

\_\_\_\_\_  
身分证字号                      年      月      日